

產品試作設備範例

領域	機型	製程	工件尺寸/爐內尺寸/皮帶寬度 (mm)	溫度
半導體	VF-1000HLP	活化退火、高溫 H2退火、真空吹掃可用	最大φ200mm	800至1800°C
	VF-5300H	退火、氧化(乾燥、熱解)	最大φ200mm	700至1350°C
	VF-5100LP	LP-CVD (Poly-Si、Si3N4、HTO)	最大φ200mm	600至850°C
	VF-3000	退火、氧化(乾、濕(鼓泡))、用於VCSEL的低溫濕法氧化	最大φ200mm	200至1100°C
	VF-1000	退火、氧化(乾、濕(汽化器))、用於VCSEL的低溫濕法氧化、可提供真空淨化	最大φ300mm	200至1100°C
	VF-1000B	VCSEL的低溫濕法氧化(濕(汽化器))	最大φ150mm	200至600°C
	VF-5700B	低溫退火、PIQ	最大φ300mm	200至750°C
	RLA-1208-V	退火、氧化(乾式)	最大φ200mm	600至1200°C
PV (光電)	206A-M100	退火、POCl3	156x156mm	400至1100°C
FPD	CCBS-IR	平板顯示器的各種熱處理	300(W)×400(L)至3000(W)×3200(L)	室溫至 250°C
電子元件	AF-INH21	電子和陶瓷元件、金屬元件和其他產品的脫脂、乾燥、	爐內尺寸：600(W)×600(H)×600(D)	室溫 +60至600°C
	AF-INH100	其他傳統方法無法提高加熱效率的產品的其他熱處理	爐內尺寸：1000(W)×1000(H)×1000(D)	
	AF-μBF		有效尺寸：200(W)×200(H)×400(D)	400至900°C
	AF-810A	電子和陶瓷元件、金屬元件等產品的脫脂、乾燥、燒成 其他傳統方法無法提高加熱效率的產品的其他熱處理	皮帶寬度：200	250至900°C
	多管道進排氣式 網帶爐	電子元件等產品的各種熱處理	皮帶寬度：350	~950°C
	小型網帶式 連續爐 810A-11	電子元件等產品的各種熱處理	皮帶寬度：200	~1000°C
	陶瓷輸送帶式 連續爐	電子元件等產品的各種熱處理	可處理工件尺寸：高達200(W)×75(H)	~1400°C
	高溫惰性氣體烤箱 INH-21GD	電子和陶瓷元件、金屬元件和其他產品的脫脂、乾燥、各種其他熱處理	爐內尺寸：600(W)×600(H)×600(D)	室溫 +60至600°C
	高溫惰性氣體烤箱 INH-51N2-DBS		爐內尺寸：800(W)×800(H)×800(D)	室溫 +60至600°C
	高溫潔淨爐 CLH-21GD(V)	半導體晶圓、玻璃基板的烘烤、固化、老化、電子元件等產品的各種熱處理	爐內尺寸：700(W)×700(H)×500(D) * 開口尺寸為630公釐。	室溫 + 70 ~ 500°C